



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT)
2025 年度營運報告

2026/03/11





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

01

經營團隊重點報告

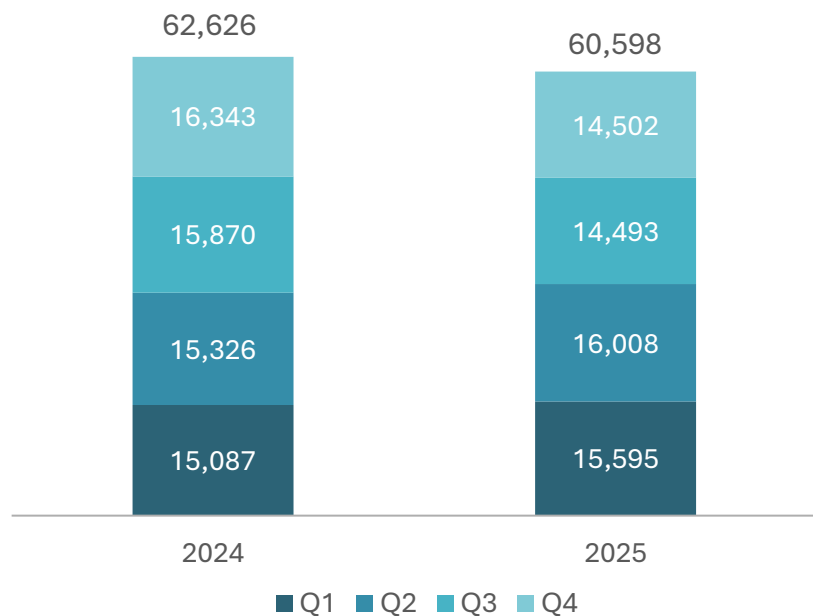
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

營業收入

- 2025年第四季 → 新台幣 145 億元，季增 0.06%
- 2025年 → 新台幣 606 億元，年減 3.24%

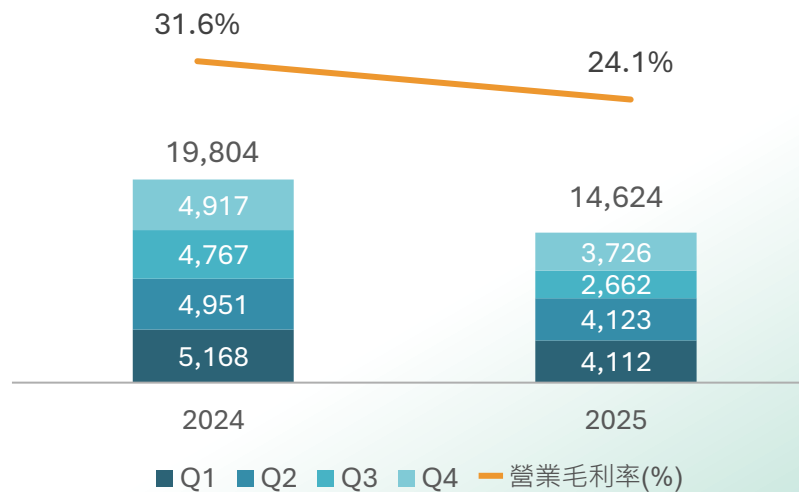
(新台幣百萬元)



營業毛利率

- 2025年第四季 → 25.7%
- 2025年 → 24.1%

(新台幣百萬元)



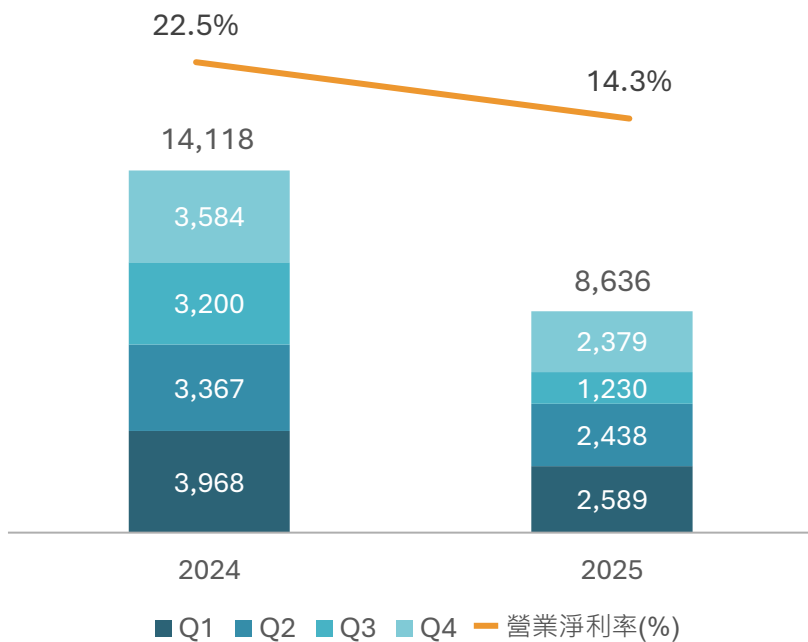
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

營業淨利率

- 2025年第四季 → 16.4%
- 2025年 → 14.3%

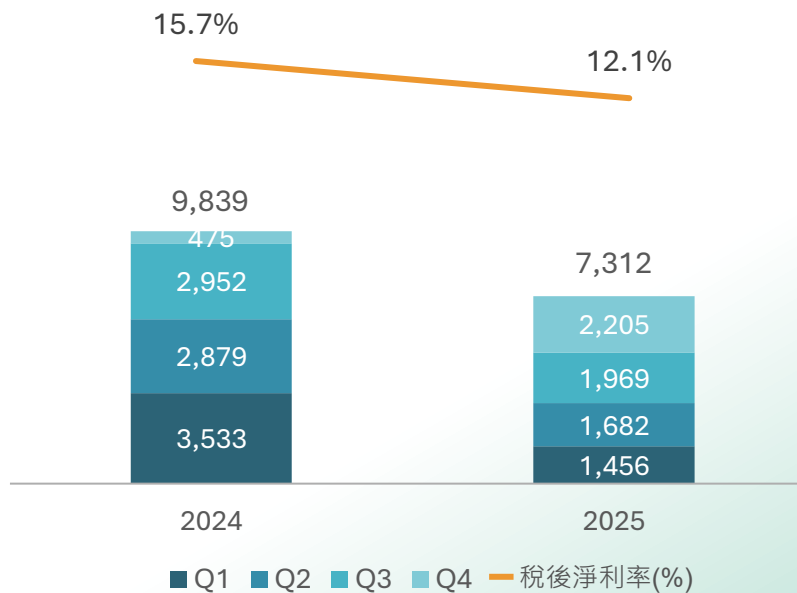
(新台幣百萬元)



稅後淨利率

- 2025年第四季 → 15.2%
- 2025年 → 12.1%

(新台幣百萬元)



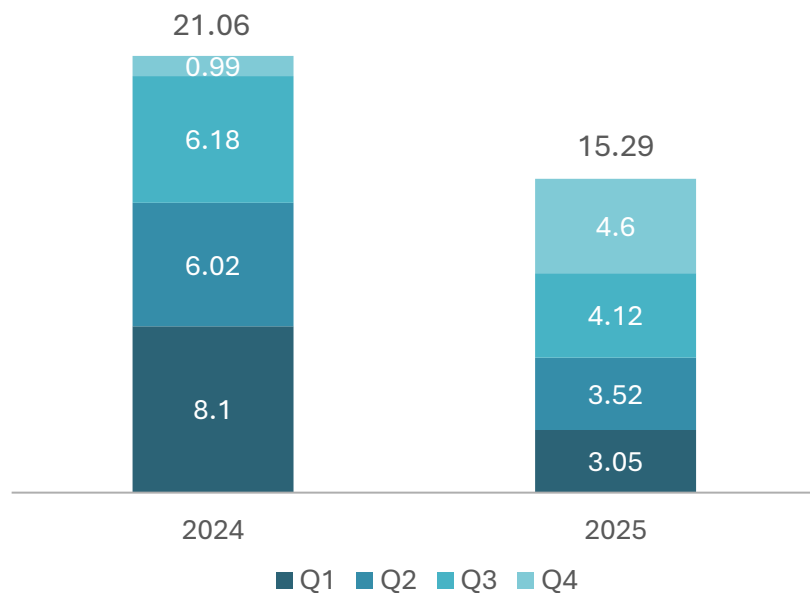
經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

每股盈餘

- 2025年第四季 → 新台幣4.60元
- 2025年 → 新台幣15.29元

(新台幣元)



預收貨款

- 新台幣249億元 (美金7.9億元)¹

股利配發

- 2025 年度股利 – 每股配發新台幣7.7元
(上半年: 新台幣2.0元 + 下半年: 新台幣5.7元)
- 2025年度股利配發率 – 50.4%
- 除權基準日 → 2026年7月22日
- 股利發放日 → 2026年8月14日

備註: 1. 換算匯率: NTD:USD = 31.4, 含保證金

2. 季度與全年每股盈餘之差異, 主要源於各季度加權平均流通在外股數不同, 因此全年 EPS 並非各季度 EPS 之簡單加總

經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ 在政策與貿易風險下，AI 驅動全球成長

- ✓ **AI 與貿易因素帶動產業展望**：在持續關注 AI 成長韌性與貿易環境複雜性的同時，人形機器人技術的興起正形成關鍵綜效，透過感測與電源技術的整合，帶動晶圓需求與精密設備成長。此趨勢要求供應鏈與區域投資策略維持高度彈性，以因應貿易緊張局勢並確保支撐 AI 生產力規模化所需的關鍵硬體供應。
- ✓ **貿易政策與營運韌性**：即使先前針對台灣之對等關稅措施已被判定無效，關稅仍被視為當前市場環境的重要因素。儘管232條款相關措施細節尚未公布，環球晶圓將關稅視為當前市場現實，並在營運規劃與執行上納入考量。美國政策持續強化半導體供應鏈韌性與支持在地投資。憑藉全球在地化布局與完善的合規管理架構，環球晶圓具備足夠的營運彈性，有效因應政策與法規變動所帶來的風險。



經營團隊重點報告

➤ 產業概況

■ AI 重塑半導體成長動能與定價能力

- ✓ **AI 驅動價值導向成長**：半導體產業成長動能正逐步轉向由高附加價值的 AI 產品所帶動，**營收結構由以出貨量為主轉向以產品單價與價值提升為核心**，降低對傳統數量循環的依賴。
- ✓ **不同製程節點復甦步調不均**：AI 需求成為主要成長支撐，**雲端與 AI 客戶優先考量效能與部署時程**，帶動先進製程需求穩定成長；成熟製程則在**供給紀律與電源及特殊應用需求支撐下**，呈現較為漸進式的復甦。
- ✓ **AI 與區域化趨勢支撐 ASP 溫和改善**：2026 年半導體晶圓市場預期較 2025 年溫和成長。AI 相關需求帶動 **12 吋先進晶圓、SOI 與氮化鎵產品之產能利用率提升**，透過產品組合優化與供給收斂，有助於平均售價逐步改善。
- ✓ **環球晶圓掌握 AI 與廣泛市場復甦機會**：順應上述產業趨勢，環球晶圓於六國擴產布局與先進製程及 AI 需求高度契合；同時，6 吋、8 吋及化合物半導體需求動能改善，包括急單挹注，亦推動各產品線更為均衡的復甦態勢。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦



運算與
AI 基礎建設



結構性韌性

- AI 基礎建設投資展現結構性韌性，主要受惠於**超大規模資料中心持續擴建**，以及朝**客製化晶片 (ASIC)** 發展的趨勢。主要業者提前布局先進製程產能，以確保未來推論需求，進一步降低對傳統半導體景氣循環的敏感度。



記憶體市場



穩健基本面

- 記憶體產業正進入由供給趨緊所驅動的結構性上升循環。產能持續轉向 **HBM 與 AI 相關應用**，**壓縮傳統產品供給**，並**強化供應商的定價能力**。此一結構性轉變亦促使 OEM 調整物料清單 (BOM) 架構，在 HBM、DDR5 與企業級 SSD 等產品間提升高附加價值記憶體比重。



智慧型手機與
個人電腦



價值導向需求

- 消費性市場正轉向價值導向需求。隨著**物料成本上升**，OEM 廠商更傾向推出高階、具 AI 功能的產品，支撐平均售價維持韌性。然而，由於消費者延長換機週期，整體**出貨量成長仍相對溫和**。

終端市場趨勢顯示成長具結構性支撐， 超越景氣循環復甦 (續)



溫和復甦

- 市場已自庫存高峰逐步回歸正常水位；惟整體庫存仍處於溫和復甦階段，供給面相對寬鬆。車用需求維持穩定但動能偏弱，各區域表現分化，電動車採用步調趨於審慎；混合動力車與軟體定義車 (SDV) 相關投資支撐車用電子需求，但成長屬漸進式而非循環性反彈。歐洲市場復甦更多來自價格與產品組合改善，而非出貨量顯著提升，顯示 2026 年將呈現偏向下半年、步調緩慢的正常化過程。



價值創造的核心引擎

- 半導體封裝已由單純的保護性結構，轉變為價值創造的核心引擎。儘管先進封裝在整體晶圓出貨量中占比不高，卻是推動 AI、高效能運算及矽光子技術突破的關鍵基礎。隨著系統複雜度與效能要求持續提升，先進及特殊晶圓於各類高端技術平台的需求同步增長。此類應用不僅提升長期訂單能見度，亦有助於支撐先進產線的穩定產能利用率。



經營團隊重點報告

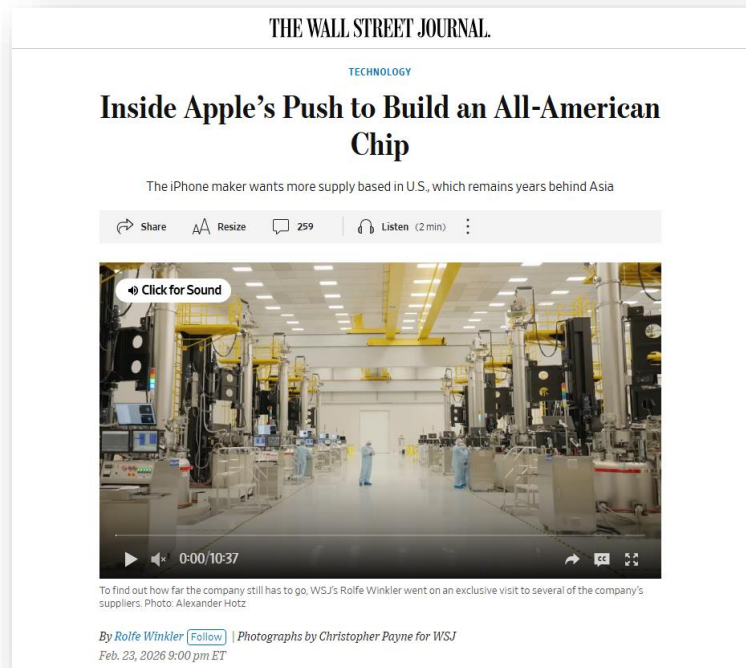
➤ 產業概況

■ 環球晶圓具備長期結構性成長優勢

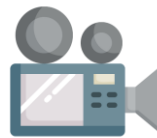
- ✓ **全球擴產逐步轉化為營收貢獻**：於亞洲、美國與歐洲推動在地化製造布局，有效分散地緣政治與供應鏈風險。亞洲與丹麥廠區之現有廠區擴產計畫(Brownfield)帶來穩健營收表現，義大利與美國新擴廠區則加速完成客戶驗證與試產出貨。隨著產能利用率提升及政府補助陸續到位，營運重心已由建廠投資轉向產能放量，擴產效益開始逐步貢獻營收。
- ✓ **AI 需求支撐產能稼動**：AI、矽光子與高效能運算需求提升先進與特殊晶圓的訂單能見度，隨著製程良率改善與產能逐步爬坡，關鍵產線稼動率得以維持穩健水準。成熟製程庫存逐步回歸健康水位，亦有助於訂單與出貨趨勢趨於穩定，需求動能呈現溫和漸進回升。
- ✓ **特殊產品組合提升獲利結構**：密蘇里廠 SOI 產線訂單能見度持續穩定。氮化鎵 (GaN) 產能滿載，新增 30% 擴產產能亦已全數獲得訂單覆蓋。碳化矽 (SiC) 產品由 6 吋與 8 吋持續推進至次世代 12 吋及半絕緣產品，並陸續進入客戶驗證階段，進一步提升高附加價值特殊產品比重。

環球晶圓德州新廠獲全球媒體關注，彰顯美國在地化布局的戰略價值

- 《華爾街日報》近期報導提及，隨著科技公司 Apple 持續推動在美國建立更完整的半導體供應鏈體系，環球晶圓位於德州謝爾曼市的新晶圓廠也被點名為重要上游供應據點之一。
- 環球晶圓德州新廠主要負責將高純度矽材料製成晶圓，提供後續晶片製造使用，是半導體產業鏈不可或缺的基礎材料來源。隨著全球供應鏈重組與在地化製造趨勢加速，環球晶圓在美國的投資與布局正逐步展現戰略價值，並持續強化於全球半導體供應鏈中的重要角色，為國際客戶提供穩定且具韌性的關鍵材料支持。



完整報導可參閱《華爾街日報》文章：
[Inside Apple's Push to Build an All-American Chip – WSJ](#)



觀看完整影片：
<https://www.youtube.com/watch?v=ktFlaBhpMu8>

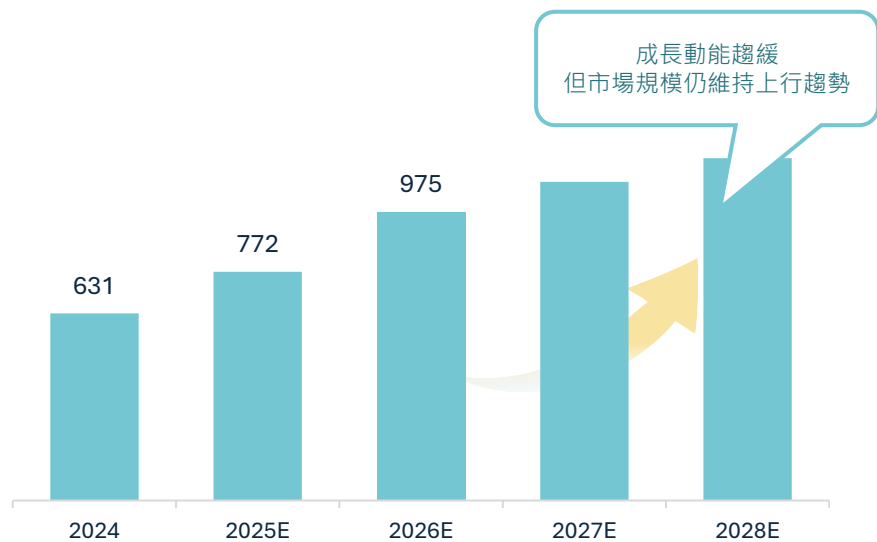
02

產業概況

半導體產業結構轉向價值導向成長

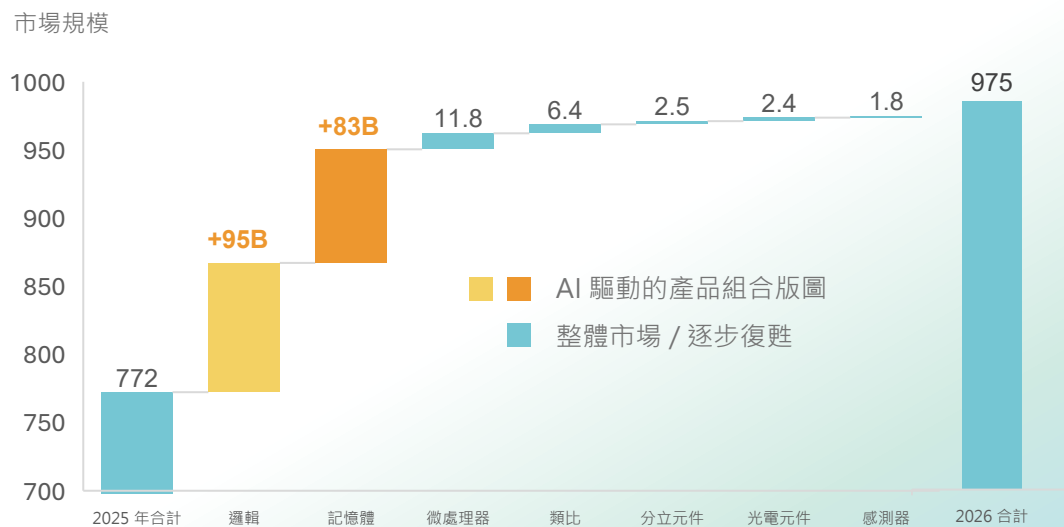
- **市場結構轉向價格驅動成長**：全球半導體市場預估於 2026 年年增約 25%，市場規模達 9,750 億美元。產業成長動能正由過往以出貨量為主，轉向以產品價值與單價提升為核心驅動。隨著 GPU、ASIC 與 HBM 等高平均售價產品占比持續提升，產業結構逐步與傳統以出貨循環為主的成長模式脫鉤。
- **先進製程為主要成長動能**：約 88% 的新增成長動能來自 AI 相關之邏輯與記憶體產品。雲端與 AI 客戶持續優先考量效能提升與快速部署能力，為先進製程與高階記憶體供應商帶來穩定且可見度較高的營收動能。
- **成熟製程邁向正常化**：展望 2026 年，產能利用率可望維持在 80% 以上，主要受惠於 AI 資料中心對矽光子 (SiPho)、矽鍺 (SiGe) 及高效率電源管理晶片 (PMIC) 等應用需求支撐。隨著 8 吋產能持續調整，有助於逐步收斂供需結構；同時，部分主要晶圓代工廠進行選擇性價格調整，也顯示定價紀律改善，並為獲利能力回升帶來契機。

全球半導體市場規模 (十億美元)



資料來源: WSTS (2025年12月); IDC (2025年12月)

全球半導體市場產品別規模 (十億美元)





環球晶圓在區域化市場中發揮全球布局優勢

- 全球半導體資本支出加速區域布局：2024 至 2030 年間，全球半導體設備支出預估將達約 1.1 兆美元。儘管先進製程仍高度集中，但在美國政策支持及供應鏈去風險需求提升的帶動下，半導體投資正由亞洲擴展至北美與歐洲，產業布局逐步呈現區域化趨勢。
- 環球晶圓受惠於均衡的全球製造版圖：在此產業結構轉變背景下，環球晶圓於亞洲、美國與歐洲建構多區域且均衡的製造布局。此多元化平台有助於深化與客戶的在地合作、回應各國在地製造需求，並有效分散地緣政治與供應鏈風險，將區域投資趨勢轉化為具實質效益且完成驗證的產能布局，強化公司長期營運韌性。

全球半導體設備累計支出

其他地區: 2%



~\$1.1 兆

2024-2030 年全球累計半導體設備支出 (預估)

環球晶圓全球擴產布局最新進展



美國 (德州)

GWA 正穩步放量，客戶驗證作業持續進行中；月產能預期可達約 30 萬片



美國 (密蘇里州)

12 吋 SOI 產線正進行 RF-SOI 及矽光子產品之客戶驗證



義大利

12 吋晶圓廠處於驗證與初期出貨階段，並獲約 25% 政府補助支持



日本

GWJ 產能持續擴充；MJL 12 吋磊晶產線擴建，支援出貨成長



韓國

新增長晶設備，擴大晶體生長產能



台灣

12 吋磊晶產線升級；同步擴充氮化鎵、方形晶圓及 12 吋碳化矽產品布局

高技術門檻特殊晶圓平台驅動長期能見度

- 高門檻特殊平台具備穩健獲利能力：FZ 與 SOI 主要應用於對**超高純度**、**嚴格規格**與**多年驗證週期**具高度要求的關鍵領域，供應商競爭者有限，客戶黏著度高，形成具結構性韌性的需求基礎與穩定獲利能力。
- 布局**電源**、**連結技術**與**新興量子應用**：除傳統半導體循環外，FZ 與 SOI 深耕於長期成長趨勢領域，包括**車用功率**、**射頻通訊**、**矽光子**、**感測技術**及**早期量子應用**等，帶來多元且非循環性的需求動能。
- 強化產品組合穩定性與長期能見度：結合 12 吋晶圓與化合物半導體產品，FZ 與 SOI 進一步提升環球晶圓高 ASP 特殊產品組合**比重**，並透過區域化製造布局與長期客戶合作關係，強化獲利穩定性與供應鏈韌性。

FZ：以超高純度構築技術護城河，並具量子應用成長潛力



超高純度與低缺陷表現



全球供應商有限、技術門檻高



量子等級基板，研究需求持續成長

SOI：垂直整合優勢結合美國在地供應優勢



SOI 平台支援 AI 與矽光子應用發展



美國在地 12 吋 SOI 晶圓廠，
具備穩定生產與可靠交付能力



唯一具備完整垂直整合、
且具專利獨立性的層轉移 SOI 平台



特殊晶圓市場預期年複合成長率 **約 10%–15%**

03

營運概況



財務摘要：2025年第四季 vs. 2025年第三季 vs. 2024年第四季

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2025年第四季	2025年第三季	2024年第四季	季成長	年成長
營業收入	14,502	14,493	16,343	0.1%	-11.3%
營業毛利 %	25.7%	18.4%	30.1%	7.3p.p.	-4.4p.p.
營業淨利	2,379	1,230	3,584	93.5%	-33.6%
營業淨利 %	16.4%	8.5%	21.9%	7.9p.p.	-5.5p.p.
本期淨利	2,205	1,969	475	12.0%	364.3%
本期淨利 %	15.2%	13.6%	2.9%	1.6p.p.	12.3p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$4.60	NT\$4.12	NT\$0.99	NT\$0.48	NT\$3.61
EBITDA* ²	4,460	4,376	2,504	1.9%	78.1%
EBITDA %	30.8%	30.2%	15.3%	0.6p.p.	15.5p.p.
EBIT ³	2,575	2,013	271	28.0%	849.1%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	9.6%	9.0%	2.0%	0.6p.p.	7.6p.p.
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	4.61%	4.2%	1.1%	0.4p.p.	3.5p.p.
資本支出 ⁶	5,826	7,018	10,484	-	-
折舊費用	1,880	2,357	2,119	-	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

6. Capex = 期末取得不動產、廠房及設備及預付設備款 - 期初取得不動產、廠房及設備及預付設備款



財務摘要：2025年 vs. 2024年

(單位: 新台幣百萬元, 除每股盈餘)	2025年	2024年	年成長
營業收入	60,598	62,626	-3.2%
營業毛利 %	24.1%	31.6%	-7.5p.p.
營業淨利	8,636	14,118	-38.8%
營業淨利 %	14.3%	22.5%	-8.2p.p.
本期淨利	7,312	9,839	-25.7%
本期淨利 %	12.1%	15.7%	-3.6p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$15.29	NT\$21.06	-NT\$5.77
EBITDA* ²	17,340	18,010	-3.7%
EBITDA %	28.6%	28.8%	-0.2p.p.
EBIT ³	8,392	9,832	-14.6%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	7.9%	12.5%	-4.6p.p.
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	3.69%	5.1%	-1.4p.p.
資本支出 ⁶	31,938	48,319	-
折舊費用	8,927	8,048	-

備註: 1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益
5. ROA = ((本期淨利 + 利息費用 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產
6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產



損益表

新台幣百萬元	2023	2024	2025	2025 (模擬) ¹
營業收入	70,651	62,626	60,598	58,114
成長率 (%) ²	0.5%	-11.4%	-3.2%	-
營業毛利	26,441	19,804	14,624	18,227
營業毛利率 (%)	37.4%	31.6%	24.1%	31.4%
EBITDA	30,630	18,010	17,340	21,678
EBITDA率 (%)	43.4%	28.8%	28.6%	37.3%
營業淨利	20,059	14,118	8,636 ³	12,704
營業淨利率 (%)	28.4%	22.5%	14.3%	21.9%
稅前淨利	26,496	12,429	9,516	13,852
稅前淨利率 (%)	37.5%	19.8%	15.7%	23.8%
稅後淨利	19,770	9,839	7,312 ⁴	10,848
稅後淨利率 (%)	28.0%	15.7%	12.1%	18.7%
每股盈餘 (NT\$)	45.41	21.06	15.29	22.69

備註: 1. 模擬數係排除美國、義大利和日本的重大擴產計畫與持有 Siltronic 股份的市值變動影響

2. 成長率係指與去年同期相比的變動幅度 (YoY)

3. 2025 年營業淨利較去年下降，主要係部分子公司試產成本增加所致

4. 2025 年稅前淨利較去年下降，主要受匯兌損失及 Siltronic 持股市價評價變動影響



資產負債表

新台幣百萬元	2023	2024	2025
資產			
現金及約當現金	26,165	38,929	19,484
應收帳款	10,116	10,265	10,113
存貨	9,359	11,238	10,399
不動產、廠房及設備	72,251	119,074	107,241 ³
其他資產	71,097	45,074	71,105
資產總計	188,988	224,581	218,343
負債			
短期借款 ¹	40,000	28,797	31,010 ⁴
應付帳款	5,027	5,371	4,161
長期借款 ²	14,542	37,678	43,244 ⁴
其他負債	62,966	61,706	46,632
負債總計	122,534	133,553	125,048
權益總計	66,454	91,028	93,295

現金資產細項包含:	
(新台幣百萬元)	2025
三個月以上定存	5,376
受限制現金	17,145
債券	6,255

備註: 1. 短期借款包括短期借款、應付短期票券，以及一年內或一營業週期內到期的長期借款、應付公司債與應付可轉換公司債
 2. 長期借款包括長期借款、應付公司債及應付海外附認股權公司債
 3. 2025年不動產、廠房及設備較去年減少，主要反映政府補助及美國 AMIC (Advanced Manufacturing Investment Credit) 稅務優惠相關之會計調整
 4. 2025年短期借款與長期借款均較去年增加，主要係因美國擴產投資所致

04

ESG

減碳治理：SBTi 承諾與集團淨零目標布局

- 環球晶圓依循科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，2025年8月正式承諾以科學為基礎設定涵蓋全價值鏈的減碳路徑，目標於 2050 年前達成溫室氣體淨零排放，以響應客戶要求、對標標竿企業、接軌國際減碳標準。
- 環球晶圓將採用 SBTi 絕對基礎設定法提出具體減碳計畫，並已同步調整再生能源規劃藍圖，以更具企圖心的能源轉型步伐對應全球氣候要求。

環球晶圓減碳策略架構



能源效率與製程優化

透過製程、設備與公用系統優化，
降低能源使用強度



再生能源導入

透過擴大太陽能建置、PPA及REC的使用，
於2040年達成100%再生能源用電目標



價值鏈議合

推動與供應商及客戶的合作，
共同降低範疇三排放

綠色製造：善用創新技術 實踐智慧製造與綠色永續雙軸轉型

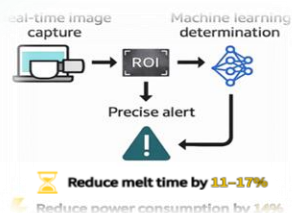


4,71M kWh Saved · 2,826 tCO₂ Reduced



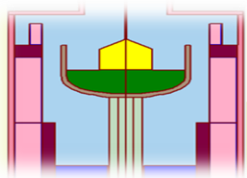
設備汰換

中德分公司啟動**大規模節能設備更新專案**，汰換近 30 年老舊設備，導入**高效變頻系統**。透過升級空壓、冰水及長晶機電源，**年節電逾 470 萬度、減碳 2,826 公噸**，顯著優化能源效率。



AI賦能優化製程

於**長晶製程**導入**AI 影像辨識**，精準掌握補料時機。此技術縮短融料時間，同時提升效率、降低能耗、優化人因操作，**單爐節電約 14%**，兼顧產能與減碳。



導入節能新材料

持續優化新型節能熱場模組，**導入熱傳導率低的新材料**取代原先的固化碳纖材質，具優異保溫效果，亦能依不同長晶爐型製作適配尺寸，可在**原有節能基礎上再降低約 5~10% 的能耗**，使製作時間大幅下降，**整體材料成本降低逾 50%**。



多元策略提升能源韌性

義大利廠參與當地「**能源釋出**」計畫，搭配**PPA**與在地**太陽能**，**2024 年綠電使用達 34%**。同時**強化熱汽電共生系統**，並導入**生質甲烷**與**回收氫氣**，有效降低二氧化碳排放量。透過多元策略加速能源轉型，穩健邁向**2031 年淨零目標**

友善職場：以人為本，打造友善安心的職場環境



員工照護與母性支持

- 韓國子公司 MKC 榮獲韓國保健福祉部「**健康友善企業**」認證
- 推動**母性保護措施**，提供孕期健康評估、個別化保護建議、孕婦車位、哺（集）乳空間等全方位支持
- 中德分公司辦理乳癌、卵巢癌及子宮頸癌三合一**婦女癌症篩檢**，並提供個別健康諮詢服務
- 美國子公司MEMC、馬來西亞子公司 KL 發起**員工子女文具贊助計畫**，邀請親子到廠區領取，讓員工子女透過簡報認識父母的工作產業



多元、平等與共融職場

- 制定人權政策與多元、平等、共融(DEI)職場宣言，打造尊重與包容的職場文化
- 連三年榮獲「**新竹科學園區推動職場工作平權優良單位評選**」優等獎殊榮
- 安排 178 位副課級以上主管與儲備幹部參與「**預防職場不法侵害**」**教育訓練**，加強管理者認知與溝通能力



負責任的勞動與職場治理

- **全體員工參與 RBA 年度教育訓練**，涵蓋勞工權益、職業健康安全、環境保護與倫理經營
- 馬來西亞子公司 KL 舉辦 RBA Awareness Week，透過多元活動讓 RBA 精神融入日常工作文化

社會關懷：結合本業核心能力 關注科學教育與支持公益



人才培育與教育促進

- 參與中央大學管理學院 40 週年院慶講座，分享半導體材料策略與永續轉型實踐
- 贊助「2025 全國智慧製造大數據分析競賽」，運用實務製程數據作為題目素材，推動智慧製造教育
- 連續2年贊助「派歐尼(Pioneer)秧苗計畫-公益科普營」，支持偏鄉學童的STEM與再生能源教育
- S.p.A. 攜手在地青年中心推動「Let Me Introduce Myself」計畫，協助當地青年建立職涯能力
- GWA 推動 STEM 教育並深化產學合作，強化當地半導體人才供給，培育半導體新世代人才
- 全球廠區與當地大專院校建立長期合作關係，強化產學合作



社會關懷：結合本業核心能力 關注科學教育與支持公益



兒少關懷與多元共融

- 支持《台灣超人》公益放映，走入宜蘭、新竹、苗栗共 12 所社區學校，為偏鄉孩童提供多元學習機會
- 推動年度公益募款活動，凝聚公司與員工力量，協助社福機構與弱勢族群獲得急難救助與重建支持
- MKC 支持身心障礙員工參與忠清南道身障運動會，透過就業與賦權行動提升弱勢族群的社會參與



社區連結與永續環境行動

- 認養竹南廠鄰近的竹南龍鳳漁港海岸，連續六年舉辦「友善地球淨灘活動」，號召員工與社區共同參與
- MKC 參與南韓天安市政府推動的「一企業一溪流」倡議，與在地社區攜手維護水域生態，並移除外來入侵植物



環球晶圓 ESG 獎項與外部肯定

<p>CDP 評鑑</p> <p>「水安全」A 領導評級 「氣候變遷」B 管理評級 供應鏈議合「A」級 (最高等級)</p> 	<p>中華信用評等公司確認信用 評等為「twAA- / twA- 1+」， 評等展望「穩定」</p> 	<p>證交所 / 櫃買中心 公司治理評鑑</p> <p>上櫃公司前 5% (連續七年)</p> 	<p>新竹科學園區研發成效獎；</p> <p>連續 6 年通過 TIPS AA 級驗證</p> 	<p>英國富時羅素永續評鑑</p> <p>連續四年入選富時永續指數 系列 (FTSE4Good Index Series) 成份股</p> 
<p>行政院環境部 國家企業環保獎</p> <p>連續 5 年獲獎</p> 	<p>TCSA 台灣企業永續獎</p> <p>永續報告書 白金級 (最高等級)</p> <p>永續綜合績效— 電子資訊製造業 第 10 名</p> 	<p>《天下雜誌》 天下永續公民獎</p> <p>2025 年排名第 15 名 (由第 27 名大幅躍升)</p> 	<p>台灣持續改善競賽 TCIA</p> <p>長晶同心鍛晶圈團隊 獲「金塔獎」</p> 	<p>「新竹科學園區 推動職場工作平權 優良單位評選」優等獎</p> <p>連續 3 年獲獎</p> 

05

Q&A